

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC25BS8xxxMR-G
標準質量: 17 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.627	シリコン	36900	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	5.952	銅	350100	7440-50-8
		錫	1400	7440-31-5
		亜鉛	1300	7440-66-6
		クロム	1500	7440-47-3
		銀	20700	7440-22-4
ダイアタッチ	0.049	銀	2900	7440-22-4
		エポキシ	500	—
ボンディングワイヤ	0.045	金	2700	7440-57-5
封止樹脂	8.030	溶融シリカ	472300	60676-86-0
		エポキシ樹脂	39300	—
		フェノール樹脂	31400	—
		金属水酸化物	15400	—
端子メッキ	0.400	錫	23500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。